

【原因・判断ポイント・発生工程】硬質の細かな異物を金めっき表面に押し付けた状態で、あるいは何らかの突起物を、負荷接触させた状態で移動させたことにより出来たもの（金めっき後工程）

【原因、判断要点、发生工序】镀金层表面压入硬物，或者某种凸块的摩擦所引起的（镀金工序后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Hard fine foreign objects are pressed against the surface of gold deposit, or some projections are placed on the surface and then the board is moved, causing the scratches. (After gold plating)



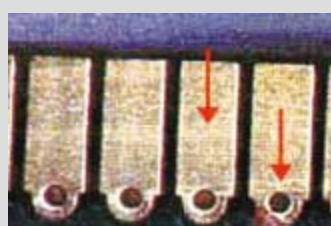
【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×
【注釋】
FPC
显微镜倍率×
【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×
【注釋】
FPC
显微镜倍率×
【Comments】
FPC
Magnification: ×

回路欠陥

SR欠陥

シンボルマーク欠陥

めっき欠陥

スルーホール欠陥

機械加工欠陥

その他欠陥

信頼性不足

はんだ上がり欠陥

電子部品装はんだ周り欠陥